

北京赛微电子股份有限公司

关于调整部分募投项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司将2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”、“MEMS先进封装测试研发及产线建设项目”实施进度进行调整。现将相关事项公告如下：

一、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680号文核准，2021年公司向特定对象发行人民币普通股90,857,535股，发行价格为25.81元/股，募集资金总额为人民币2,345,032,978.35元，扣除发行费用11,600,291.50元（不含增值税），募集资金净额为2,333,432,686.85元。

该募集资金已于2021年8月23日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2021]000007号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	8英寸MEMS国际代工线建设项目	259,752.00	79,051.98
2	MEMS高频通信器件制造工艺开发项目	32,580.00	32,580.00
3	MEMS先进封装测试研发及产线建设项目	71,080.00	71,080.00
4	补充流动资金	51,791.32	51,791.32
合计		415,203.32	234,503.30

二、本次调整部分募投项目实施进度的情况

1、募投项目实施情况

截至2023年11月30日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资金额	累计投入金额	投资进度
1	8英寸MEMS国际代工线建设项目	259,752.00	79,051.98	79,051.98	79,289.30	100.30%
2	MEMS高频通信器件制造工艺开发项目	32,580.00	32,580.00	14,580.00	-	-
3	MEMS先进封装测试研发及产线建设项目	71,080.00	71,080.00	71,080.00	61,632.87	86.71%
4	补充流动资金	50,631.29	50,631.29	68,631.29	68,562.23	99.90%

注：公司于2023年8月2日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将用于“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”的部分募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的32,580万元缩减为14,580万元，并将变更的该部分募集资金18,000万元永久补充流动资金。该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2、本次部分募投项目进度调整情况

序号	项目名称	计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到可使用状态日期
1	MEMS高频通信器件制造工艺开发项目	2023年12月31日	2024年6月30日
2	MEMS先进封装测试研发及产线建设项目	2024年1月31日	2025年12月31日

三、本次调整部分募投项目实施进度的原因

“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”原由北京赛莱克斯国际科技有限公司统筹协调，原计划组织公司全资子公司瑞典Silex（Silex Microsystems AB）与公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）的境内外人才、工艺资源，以共同推进相关工艺开发，并在本土实现沉淀吸收。但该项目后续一直处于实施准备阶段，一方面，募集资金到位后相关跨境工作的组织实施遇到外部障碍；另一方面，赛莱克斯北京在自主开发及商业活动中已成功积累相关工艺，高频通信MEMS器件的相关制造工艺研发工作已获得开展，部分型号高频通信MEMS器件的相关制造工艺已成功解决。现在公司计划变更该募投项目的实施主体和实施地点，由新投资设立的北京海创微元科技有限公司继续实施该募投项目，因此公司结合目前募集资金实际使用情况及未来发展规划，

经过谨慎研究，将该募投项目的计划达到可使用状态日期进行调整，由原计划的2023年12月31日调整至2024年6月30日。

“MEMS先进封装测试研发及产线建设项目”目前仍处于建设阶段，在试验线层面，截至目前已建成并运营，与客户需求对接、工艺技术开发、部分产品试制等相关活动已在公司现有条件下展开，工艺技术团队搭建持续进行，与项目相关的设备采购已大规模实施，该项目目前已在公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司MEMS基地内租赁部分空间并建成一条小规模试验线；在商业线层面，基于产线选址、资源要素、发展战略规划等方面的考量，公司仍在谨慎商讨决策具体建设方案。因此，根据该募投项目的实际开展情况，经审慎研究，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等的前提下，将该募投项目的计划达到可使用状态日期进行调整，由原计划的2024年1月31日调整至2025年12月31日。

四、本次调整部分募投项目实施进度的影响

公司本次调整部分募投项目实施进度是公司根据募投项目实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目建设的内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将充分利用现有资源加快推进项目建设。公司本次募投项目投资进度调整不会对公司生产经营造成不利影响。

五、履行的审议程序及相关意见

1、董事会意见

2023年12月14日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司将“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”计划达到可使用状态日期由2023年12月31日调整至2024年6月30日，将“MEMS先进封装测试研发及产线建设项目”计划达到可使用状态日期由2024年1月31日调整至2025年12月31日。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次调整部分募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此我们一致同意公司对部分募投项目实施进度进行调整。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，不会对募投项目实施产生重大不利影响，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，因此监事会同意公司对部分募投项目实施进度进行调整。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次公司调整部分募投项目实施进度事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的内部审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。本保荐机构对公司本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中泰证券股份有限公司关于北京赛微电子股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日